

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



鴻騰六零八八精密科技股份有限公司

(於開曼群島以鴻騰精密科技股份有限公司的名稱註冊成立的有限公司，
並以鴻騰六零八八精密科技股份有限公司於香港經營業務)

(股份代號：6088)

公告

本公告乃由鴻騰六零八八精密科技股份有限公司（於開曼群島以鴻騰精密科技股份有限公司的名稱註冊成立的有限公司，並以鴻騰六零八八精密科技股份有限公司於香港經營業務）（「本公司」）作出之自願公告。

本公司之董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司全資附屬公司 Foxconn Interconnect Technology Singapore Pte. Ltd. 計劃增加其於其全資附屬公司 New Wing Interconnect Technology (Bac Giang) Limited 之股本投資。有關該股本增資建議之進一步資料，請參閱本公司之控股股東鴻海精密工業股份有限公司(於台灣證券交易所上市，股份代號：2317)於公開資訊觀測站的網址 <http://mops.twse.com.tw/mops/web/index> 所發佈日期為 2017 年 8 月 18 日之公告。

承董事會命
鴻騰六零八八精密科技股份有限公司*
盧松青
董事會主席

香港，二零一七年八月十八日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事為盧松青先生、盧伯卿先生及 GILLESPIE William Ralph 先生；非執行董事為陳傑良博士；以及獨立非執行董事為 CURWEN Peter D 先生、鄧貴彰先生及陳永源先生。

* 於開曼群島以鴻騰精密科技股份有限公司的名稱註冊成立的有限公司，並以鴻騰六零八八精密科技股份有限公司於香港經營業務